

## 技術をコンピタンスとして グローバルトップへ

高井 明 (たかい あきら)

富士電機デバイステクノロジー株式会社  
取締役社長



新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては決意も新たに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

富士電機デバイステクノロジー株式会社が発足し、1年を経過致しました。昨年を振り返りつつ今年の抱負を述べます。

富士電機デバイステクノロジー株式会社のミッションは、半導体、ストレージ、画像デバイスの事業を通して顧客、株主および従業員にとっての企業価値を最大限に高めることです。これら三つの事業ユニットに共通することは、市場成長率が高いことであり同時に競争が激しいこと、競合は世界中にいることなどの特徴があります。こうした背景下、富士電機デバイステクノロジー株式会社は、「技術をコンピタンスとしてグローバルトップを目指す」を経営方針としました。コンピタンスとする技術は、解析・分析技術、材料技術などの共通的な基盤技術、薄膜形成技術、クリーン化技術、洗浄技術などのプロセス技術、IGBT、CMOS、磁性薄膜、有機感光体などのデバイス技術、パワーエレクトロニクス、パワーマネジメントなどのアプリケーション技術です。これらの要素技術をコンピタンス、すなわち強みとしてさらに強化する研究開発に取り組んでいます。

カンパニーメッセージとして「高品質の追求」を表現する“*Quality is our message*”を用いています。その意味合いは、富士電機デバイステクノロジー株式会社がお客様に提供する製品とサービスの品質で高い評価を受けることです。すなわち、もの作りシステムの品質を高めることであり、メーカーとして生産現場の高いスループット、高い良品率、短いリードタイム、極小の棚卸資産・在庫など

の達成をすることにより実現されます。製品そのものの品質だけでなく、日常のビジネスプロセスで高い品質を追求することがこのカンパニーメッセージ“*Quality is our message*”の意味するところです。

事業運営方針について述べますと、半導体事業では、パワーマネジメント分野に特化して自動車電装、産業、情報・電源用半導体でグローバルトップを目指します。例をあげれば、自動車向けは独自技術である自己分離技術による統合IC、ワンチップイグナイタ、ワンチップ圧力センサの展開、産業向けは低損失化、高信頼性を目指したIGBTモジュールの展開、情報電源向けはデジタルカメラ・ビデオカメラ向け高性能電源IC、プラズマテレビ向けドライバ、低損失MOSFETの展開です。ディスク媒体事業ではパソコン用に急速に拡大しつつあるコンシューマー用を加えてグローバルトップのディスク媒体外販メーカーを目指します。昨年はガラス基板媒体の量産化を開始し、今年は垂直媒体の量産化に向け開発を加速します。画像デバイス事業では中国拠点のメリットを生かし、グローバルトップの感光体外販メーカーを目指します。高速印刷・高画質化に対応するための材料開発、シミュレーション技術、解析技術開発を行っています。

富士電機デバイステクノロジー株式会社で扱う技術・製品はデジタルという時代の中で、より豊かな社会を目指した製品、省エネルギーなど環境へ配慮した製品により社会に貢献しております。今後もこれらの事業活動を通じて高品質の製品を高品質の技術・サービスと共にお客様に提供し、お客様と共に喜び共に成長する富士電機デバイステクノロジー株式会社を目指していく所存です。